

BIO SOLUBLE

**3R2770HT**

## Description

Conçu selon un processus spécial de filature à base de calcium, de magnésium et de silice, le 3R2770HT offre plus d'avantages que les fibres isolantes des matériaux haute température. Il conserve ses propriétés, même lorsqu'il est utilisé avec une tension élevée ou qu'il est soumis à des conditions atmosphériques humides.

Les produits fabriqués à partir de ce matériel contiennent peu de particules non fibreuses, communément appelées « shot ». Ils offrent alors une bonne conductivité thermique, ce qui minimise les pertes de chaleur et réduit les températures de surface, ainsi que les frais d'exploitation.

## Applications

Le papier biosoluble 3R2770HT n'adhère pas aux métaux en fusion. Il peut donc être utilisé dans les creusets, les garnitures et les autres endroits qui entrent en contact direct avec l'aluminium liquide.

De plus, parce qu'il possède une bonne stabilité thermique, des capacités isolantes ainsi qu'une force de traction élevée, les applications de ce matériel incluent les possibilités suivantes:

- Écran thermique pour four isolant
- Revêtement de portes et de couvercles de four
- Protection générale contre la chaleur
- Revêtement de four de traitement / homogénéisation

## Spécifications

### Données techniques

|                                                                                                    |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                                                                                            | Blanc                                                                                      |
| Densité                                                                                            | 11-13 lbs/pi <sup>3</sup>                                                                  |
| Épaisseur                                                                                          | 1/16" à 1/4"                                                                               |
| Température                                                                                        | Continue: 1150°C (2102°F), Courte durée: 1300°C (2370°F), Point de fusion: 1400°C (2550°F) |
| Conductivité thermique, BTU*po/hr pi <sup>2</sup> °F (w/m.k) ASTM C201 Température @ 260°C (500°F) | 0.39 (0.06)                                                                                |

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Conductivité thermique, BTU*po/hr pi² °F (w/m.k) ASTM C201 Température @ 535°C (1000°F) | 0.65 (0.09) |
| Conductivité thermique, BTU*po/hr pi² °F (w/m.k) ASTM C201 Température @ 815°C (1500°F) | 1.02 (0.15) |

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.